

R485H05S-T16

SOIC16 封装 RS485 半双工隔离收发器

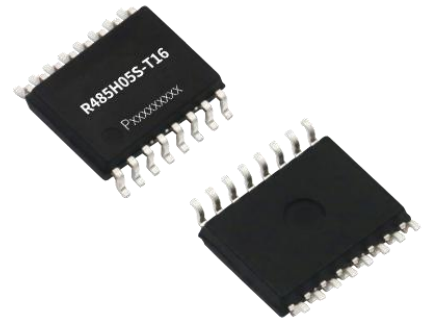
R485H05S-T16

SOIC16 封装 RS485 半双工隔离收发器

产品特点

- 超小，超薄，芯片级 SOIC16 封装
- 符合 TIA/EIA-485-A 标准
- 宽供电电源范围 3.0-5.5V
- 集成高效隔离电源，具有过载和短路保护
- I/O 电压范围支持 3.3V 和 5V 微处理器
- 隔离耐压高达 5000Vrms
- 总线静电防护能力高达 $\pm 8\text{kV}$ (HBM)/ $\pm 4\text{kV}$ (接触放电)
- 通讯速率 20Mbps
- 高共模瞬态抗扰度 180kV/ μs (典型值)
- 纳秒级通讯延时
- 1/8 单位负载，总线负载能力高达 256 节点
- 总线失效保护
- 总线驱动短路保护
- 工业级工作温度范围：-40°C to +125°C

产品外观



RoHS

应用范围

- 工业自动化
- 楼宇自动化
- 智能电表
- 远距离信号交互、传输

功能描述

R485H05S-T16 是为 RS-485/RS-422 总线网络设计的一款隔离型半双工增强型收发器，具有高电磁抗扰度和低辐射特性，且完全符合 TIA/EIA-485-A 标准。总线接收器采用 1/8 单元负载设计，其总线负载能力高达 256 个节点单元，满足多节点设计需求。总线传输速率可达 20Mbps。

R485H05S-T16 器件具有高绝缘能力，有助于防止数据总线或其他电路上的噪声和浪涌进入本地接地端，从而干扰或损坏敏感电路。高 CMTI 能力可以保证数字信号的正确传输。更在传统 IC 基础上重点加强 A、B 引脚可靠性设计，其中包括驱动器过流保护，增强型 ESD 设计等，其 A、B 端口 ESD 承受能力可达 $\pm 8\text{kV}$ (HBM)及 $\pm 4\text{kV}$ (接触放电)。

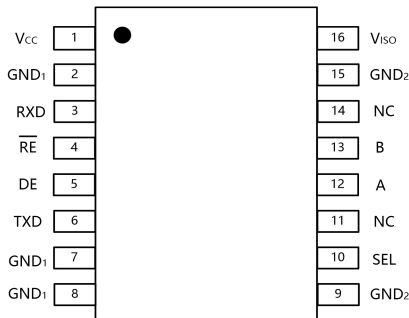
R485H05S-T16

SOIC16 封装 RS485 半双工隔离收发器

目录

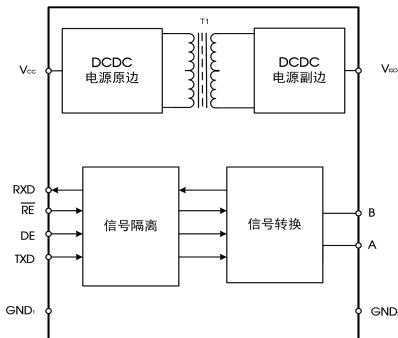
1 首页.....	1	3.4 传输特性.....	5
1.1 特点及外观.....	1	3.5 物理特性.....	6
1.2 应用范围.....	1	4 参数测量电路.....	6
1.3 功能描述.....	1	5 工作描述及功能.....	7
2 引脚封装及描述.....	2	6 应用电路.....	7
3 IC 相关参数.....	3	7 使用建议.....	7
3.1 极限额定值.....	3	8 订购信息.....	8
3.2 推荐工作参数.....	3	9 封装信息.....	9
3.3 电学特性.....	4	10 包装信息.....	10

引脚封装



注：所有 GND₁ 内部是相连的；
所有 GND₂ 内部是相连的；

内部框图



真值表

字母	描述
H	高电平
L	低电平
X	无关
Z	高阻抗

表 1. 驱动器真值表

TXD	DE	输出	
		A	B
H	H	H	L
L	H	L	H
X	L	Z	Z

R485H05S-T16

SOIC16 封装 RS485 半双工隔离收发器

表 2. 接收器真值表

差分输入 $V_{ID} = (V_A - V_B)$	$\overline{RE}$	RXD
$-0.01\text{ V} \leq V_{ID}$	L	H
$-0.21\text{ V} < V_{ID} < -0.01\text{ V}$	L	不确定的
$V_{ID} \leq -0.21\text{ V}$	L	L
X	H	Z
开路	L	H

注：

①驱动状态时 DE、 $\overline{RE}$ 引脚接高电平；

②接收状态时 DE、 $\overline{RE}$ 引脚接低电平。

引脚描述

引脚编号	引脚名称	功能描述
1	V_{CC}	逻辑侧供电引脚。靠近该引脚须接入 0.1 μF 和 10 μF 陶瓷电容到逻辑侧参考地 (GND_1)。
2	GND_1	逻辑侧参考地。
3	RXD	接收器输出引脚
4	$\overline{RE}$	接收器使能引脚。 $\overline{RE}$ 为低电平，当 $(A-B) \geq -10\text{mV}$ ，RXD 输出为高电平，当 $(A-B) \leq -210\text{mV}$ ，RXD 输出为低电平。
5	DE	驱动器使能引脚。当 DE 为高电平时，驱动器输出使能；当 DE 为低电平时，驱动器输出为高阻抗；当 DE 为低电平，且 $\overline{RE}$ 为高电平时，进入关断模式。
6	TXD	驱动器输入引脚。
7	GND_1	逻辑侧参考地。
8	GND_1	逻辑侧参考地。
9	GND_2	总线侧参考地。
10	SEL	隔离电源 V_{ISO} 输出电压选择引脚。
11	NC	无功能引脚，可悬空。
12	A	RS485 总线 A 线引脚。
13	B	RS485 总线 B 线引脚。
14	NC	无功能引脚，可悬空。
15	GND_2	总线侧参考地。应用时需与 Pin9 相连接。
16	V_{ISO}	隔离电源输出。靠近该引脚须接入 0.1 μF 和 10 μF 陶瓷电容到总线侧参考地 (GND_2)。

注：当 SEL 接到 V_{ISO} 时， $V_{ISO}=5\text{V}$ 。当 SEL 接到 GND_2 或者悬空时， $V_{ISO}=3.3\text{V}$ 。当 V_{CC} 电压为 3.3V 时，SEL 只能接地或者悬空；当 V_{CC} 电压为 5V 时，SEL 不受限制。

极限额定值

参数	单位
供电电压 V_{CC}	-0.5V to +6V
输出电压 V_{in}	-0.5V to $V_{CC}+0.5\text{V}$
输出电流 I_o	-10mA to +10mA
结温 T_j	$< 150^\circ\text{C}$
工作温度范围	-40°C to $+125^\circ\text{C}$
存储温度范围	-65°C to $+150^\circ\text{C}$

R485H05S-T16

SOIC16 封装 RS485 半双工隔离收发器

- ①若超出“极限额定值”表内列出的应力值，可能会对器件造成永久损坏。长时间工作在极限额定条件下，器件的可靠性有可能会受到影响。所有电压值都是以参考地(GND)为参考基准。最大电压不得超过 6V；
- ②下列数据是在自然通风，正常工作温度范围内测得（除非另有说明）。

电气特性

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
驱动器特性						
$ V_{OD3} $	差分输出电压绝对值	空载, SEL 为低电平或 悬空	3.0	--	--	V
		空载, SEL 为高电平	4.5	--	--	
		RL=54 Ω , SEL 为低电平或 悬空	1.5	--	--	
		RL=54 Ω , SEL 为高电平	1.5	--	--	
ΔV_{OD}	驱动器差分输出电压变化量	空载, 图 2	-0.2	--	0.2	
V_{IH}	高电平输入电压	TXD, DE	2	5	5.5	
V_{IL}	低电平输入电压	TXD, DE	0	--	0.8	
I_{IH}	输入高电平漏电流	TXD, DE	--	--	20	uA
I_{IL}	输入低电平漏电流	TXD, DE	-20	--	--	
I_A	驱动器短路电流		--	± 150	± 250	mA
CMTI	共模瞬变抗扰度	$V_{CM} = 1200V$; 图 7	--	180	--	kV/ μ S
接收器特性						
$V_{IT(+)}$	正向差分输入阈值电压	$-7V \leq V_{CM} \leq +12V$	--	--	-10	mV
$V_{IT(-)}$	负向差分输入阈值电压	$-7V \leq V_{CM} \leq +12V$	-210	--	--	
V_{hys}	回滞电压 ($V_{IT+} - V_{IT-}$)	$-7V \leq V_{CM} \leq +12V$	--	30	--	
V_{OH}	RXD 高电平输出电压		$V_{CC} - 0.4$	4.8	--	V
V_{OL}	RXD 低电平输出电压		0	0.2	0.4	
V_{IH}	高电平输入电压	$\overline{RE}$	0.7VCC	--	--	
V_{IL}	低电平输入电压	$\overline{RE}$	--	--	0.3VCC	
I_{IH}	输入高电平漏电流	$\overline{RE}$	--	--	20	uA
I_{IL}	输入低电平漏电流	$\overline{RE}$	-20	--	--	
R_{ID}	差分输入阻抗(A, B)	$-7V \leq V_{CM} \leq +12V$	96	--	--	k Ω
供电及保护特性						
V_{ISO}	隔离电源输出电压	$V_{CC}=5V$ 或3.3V, SEL 为低电平或悬空	3.1	3.3	3.5	V
		$V_{CC}=5V$, SEL 为高电平	4.8	5.0	5.30	
I_{CC}	逻辑侧供电电流	A 和 B 空载, SEL 为低电平或悬空	--	14	25	mA
		A 和 B 空载, SEL 为高电平	--	17	25	
		最大工作电流, SEL 为低电平或悬空	--	87	160	
		最大工作电流, SEL 为高电平	--	141	200	
ESD	HBM 模式	A、B 端口	--	--	± 8	kV
	接触放电模式	A、B 端口	--	--	± 4	
V_{IO}	隔离电压	$V_{TEST}=V_{IO}$, $t=60s$ $V_{TEST}=1.2 \times V_{IO}$, $t=1s$ (100%生产测试)	--	--	5000	VAC
R_{IO}	绝缘阻抗	500VDC	1	--	--	G Ω

R485H05S-T16

SOIC16 封装 RS485 半双工隔离收发器

传输特性

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
-	传输速率	占空比 40% ~ 60%	--	--	20	Mbps
T_{PHL}, T_{PLH}	驱动器传输延时	$R_L=54\Omega$, $C_{L1}=C_{L2}=50pF$ 图 3	--	45	80	ns
$ T_{PHL}-T_{PLH} $	驱动器差分输出延时偏移		--	--	25	
T_R, T_F	驱动器输出上升延时、下降延时		--	8	25	
t_{PZH}/t_{PZL}	驱动关闭使能传播延迟	图 6	--	--	110	
t_{PHZ}/t_{PLZ}	驱动开启使能传播延迟		--	--	110	
T_{PHL}, T_{PLH}	接收器传输延时	$R_L=54\Omega$ $C_L=15pF$, 图 4	--	88	150	
$ T_{PHL}-T_{PLH} $	接收器传输延时偏移		--	--	25	
T_R, T_F	接收器输出上升延时、下降延时	$R_L=54\Omega$ $C_{L1}=C_{L2}=50pF$ 图 4 图 5	--	2	10	
t_{PLH}	接收关闭使能传播延迟, 输出低电平至高电平时间		--	--	110	
t_{PHL}	接收开启使能传播延迟, 输出高电平至低电平时间		--	--	110	

物理特性

参数	数值	单位
重量	0.4(Typ.)	g

参数测试电路

注意：测试条件负载电容包括测试探头及测试夹具寄生电容（无特殊说明）。测试信号上升及下降沿 $<6ns$ ，频率 100kHz，占空比 50%。阻抗匹配 $Z_0 = 54\Omega$ （无特殊说明）。

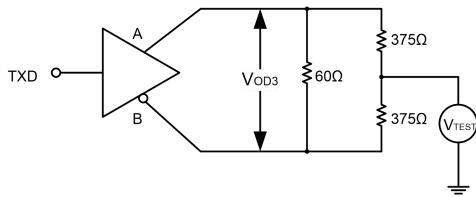


图 1. 共模输出测试电路

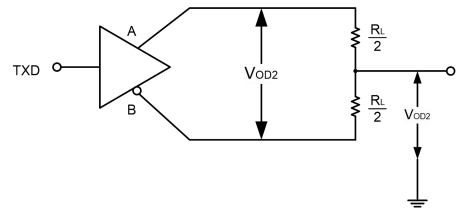
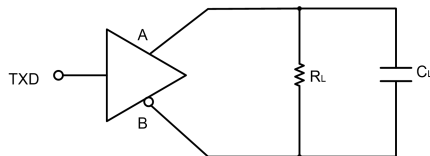


图 2. 差分输出测试电路



注： C_L 包含夹具及仪器寄生电容

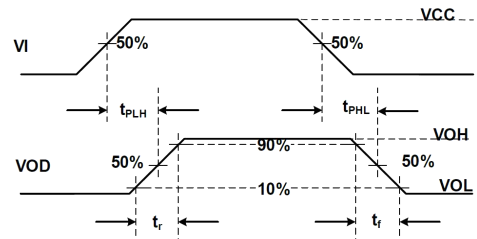
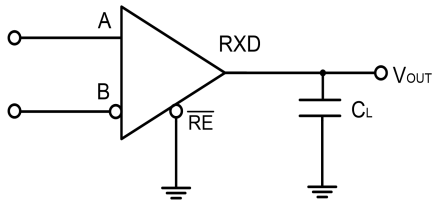


图 3. 发送延时测试电路

R485H05S-T16

SOIC16 封装 RS485 半双工隔离收发器



注: C_L 包含夹具及仪器寄生电容

图 4.接收延时测试电路

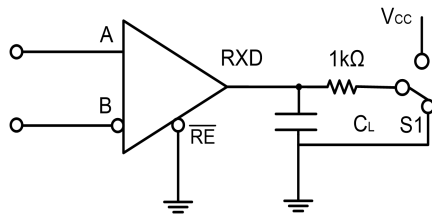
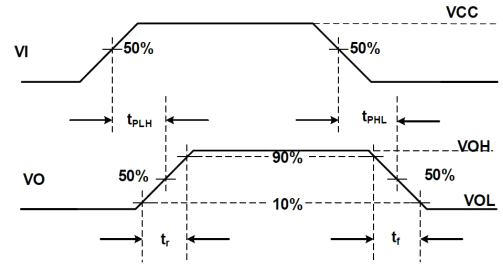
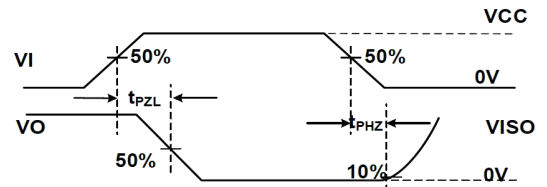
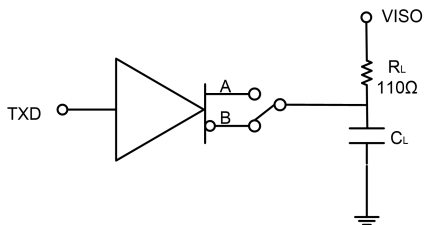
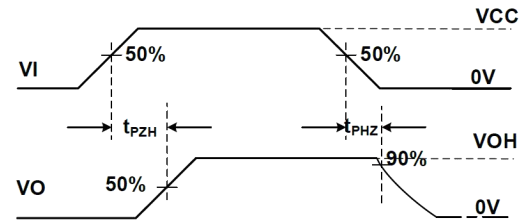
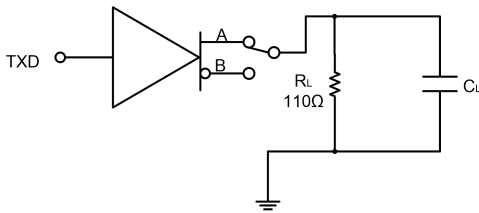
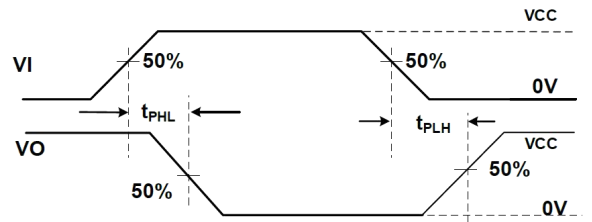


图 5.接收开启、关闭时间测试电路



注: C_L 包含夹具及仪器寄生电容

图 6.驱动开启、关闭时间测试电路

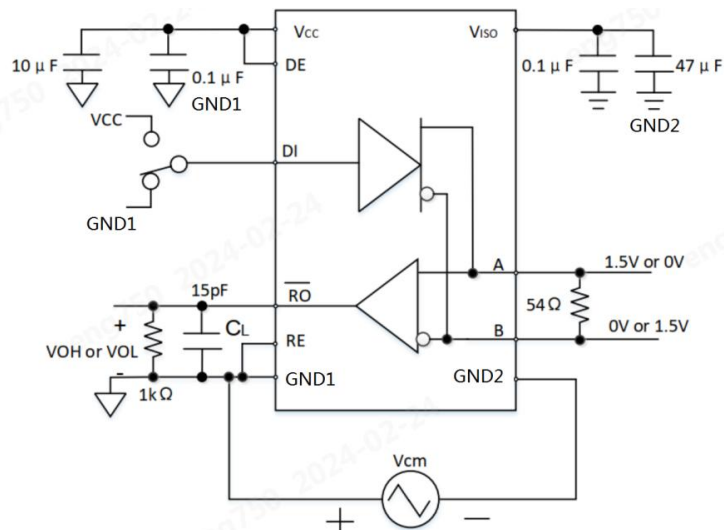


图 7.CMTI 测试电路

R485H05S-T16

SOIC16 封装 RS485 半双工隔离收发器

工作描述及功能

R485H05S-T16 是一款带隔离电源的半双工 RS-485 隔离收发器。每个收发器里除了包含一个隔离电源外，还包含一个驱动器和一个接收器。该收发器具备总线失效保护功能，当接收器输入开路、短路或者当总线处于空闲状态时，能保证接收器输出为高电平。具有失效安全，过流保护和过热保护功能。

总线失效保护：接收器输入短路或开路，挂在终端匹配总线上的所有驱动均处于禁用状态时（idle），R485H05S-T16 产品可确保接收器输出逻辑高电平。这是通过将接收器输入门限分别设置为 -210mV 和 -20mV 实现的。若差分接收器输入电压 $(A-B) \geq -10\text{mV}$ ，RO 为逻辑高电平；若电压 $(A-B) \leq -210\text{mV}$ ，RO 为逻辑低电平。当挂接在终端匹配总线上的所有发送器都禁用时，接收器差分输入电压将通过终端阻拉至 0V 。依据接收器门限，可实现具有 -10mV 最小噪声容限的逻辑高电平。 -210mV 至 -10mV 门限电压是符合 EIA/TIA-485 标准的。

总线负载能力（256 节点）：标准的 RS485 接收器输入阻抗定义为 $12\text{k}\Omega$ （1 个单位负载）。一个标准的 RS485 驱动器可以驱动至少 32 个单位负载。R485H05S-T16 的总线接收器按 $1/8$ 单位负载设计，其输入阻抗大于 $96\text{k}\Omega$ 。因此，总线能允许接入更多的收发器（高达 256 个）。R485H05S-T16 也可与其他 32 个单位负载的标准 RS485 收发器混合使用（接收器累计不能超过 32 个单位负载）。

应用电路

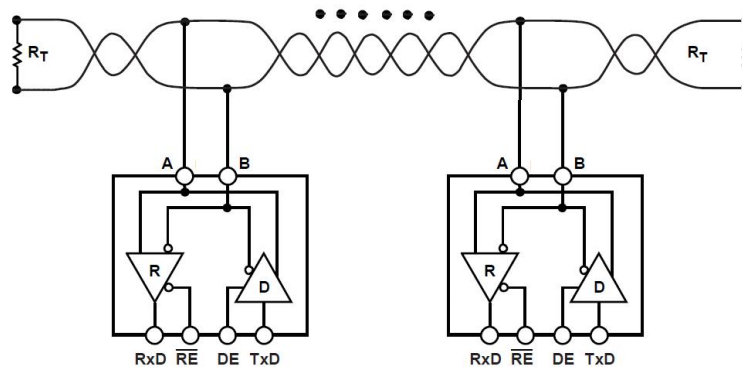


图 8. 典型应用电路（半双工网络拓扑结构）

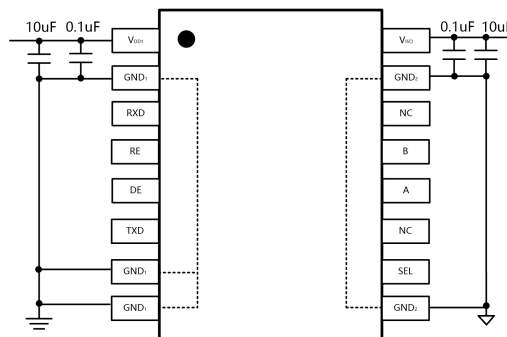


图 9. 典型应用图

PCB 设计说明：

1、VCC 与 GND1、VISO 与 GND2 的去耦电容及储能电容应尽可能摆放在靠近芯片引脚的位置，以减少环路面积和 PCB 走线的寄生电感。一般应控制在 2mm 以内。去耦电容放在靠近芯片的位置，储能电容放在外侧。如下图 10-1 所示。

R485H05S-T16

SOIC16 封装 RS485 半双工隔离收发器

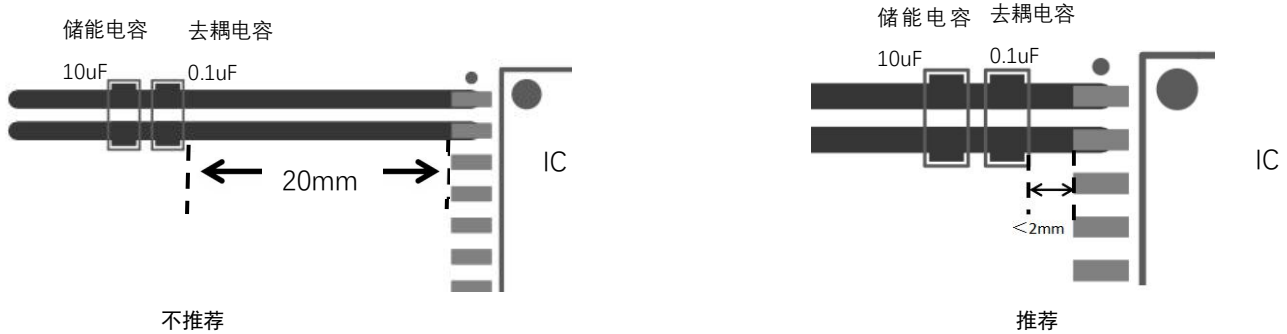


图 10-1

2、布线时应设计电源线宽至少 0.5mm。

3、当需要在供电电源线和地线中放置过孔时，过孔的位置应在电容相对芯片引脚的外侧，而非放置在电容与芯片之间，如下图 10-2 所示，以减少过孔寄生电感的影响。

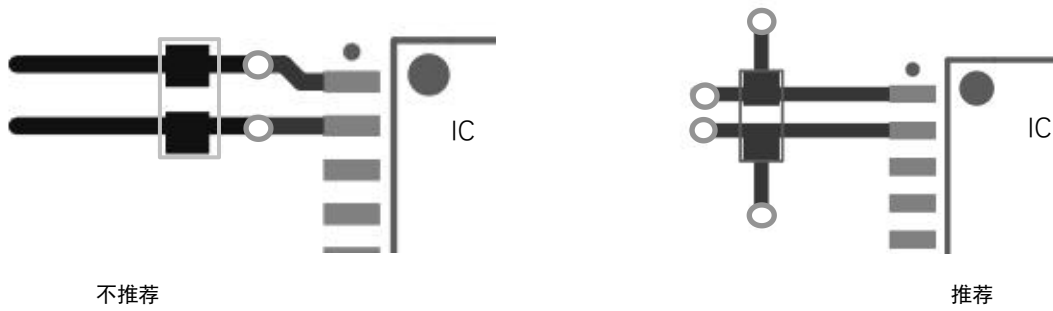


图 10-2

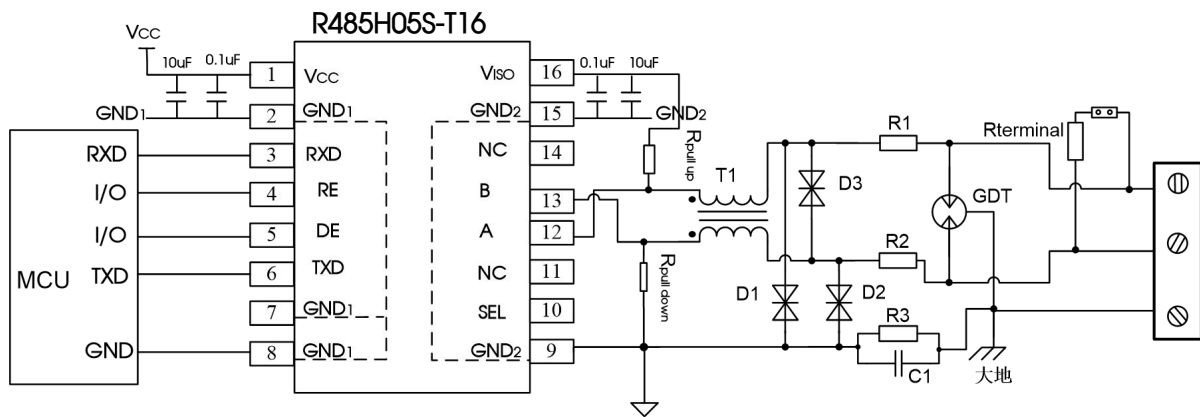


图 11.端口保护推荐电路

参数说明:

标号	选型	标号	选型
R3	1M Ω	R1, R2	2.7 Ω / 2W
C1	1nF, 2kV	D1, D2	SMBJ6.5CA
T1	ACM2520-301-2P	D3	SMBJ6.5CA
GDT	B3D090L	R _{terminal}	120 Ω

由于模块内部 A/B 线自带 ESD 保护，因此用户一般在应用于环境良好的场合时无需再加 ESD 保护器件。但如果应用环境比较恶劣(如高压电力、雷击等环境)，那么建议用户一定要在模块 A/B 线端外加 TVS 管、共模电感、气体放电管、屏蔽双绞线或同一网络单点接大地等保护措施。因此，推荐应用电路如图 11 所示，推荐参数如上表所示。推荐电路图和参数值只做参考，请根据实际情况来确定是否需要电路图中的器件和适当的参数值。

注：R_{terminal} 根据实际应用情况选择。

R485H05S-T16

SOIC16 封装 RS485 半双工隔离收发器

使用建议

- ① 产品不支持热拔插。
- ② TXD 外部输入如驱动能力不足应视情况添加上拉电阻。
- ③ 为保持总线空闲稳定性，需要在总线端至少一处节点将 A 上拉至 VISO，将 B 下拉至 GND₂。

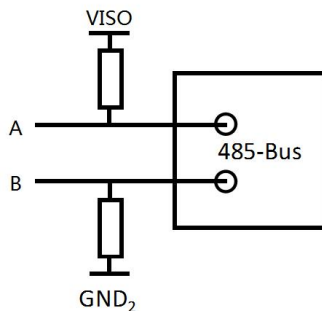


图 12. 上下拉电阻典型接法

- ④ DE 与 RE 引脚不支持悬空，如该引脚不接入控制器，该引脚推荐通过 30k Ω 的下拉电阻接至 GND，以保持该节点只处于接收状态，不影响总线。
- ⑤ 在任何时候都不应该将控制器连接 DE, RE, TXD 的引脚设置为开漏输出的状态，否则会导致不确定的后果。

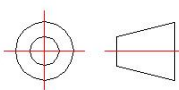
订购信息

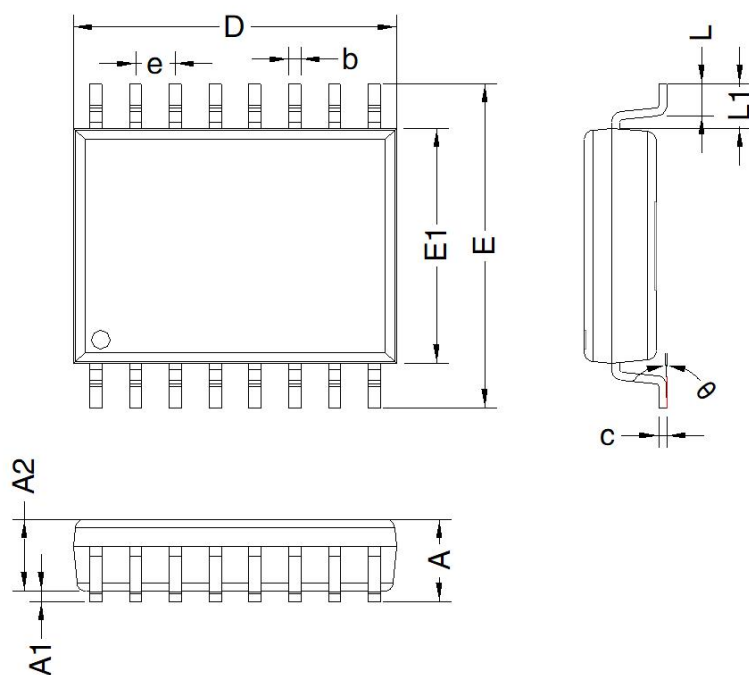
产品型号	封装	引脚数	丝印	包装
R485H05S-T16	SOIC	16	R485H05S-T16	340/盘

R485H05S-T16

SOIC16 封装 RS485 半双工隔离收发器

封装信息

第三角投影 

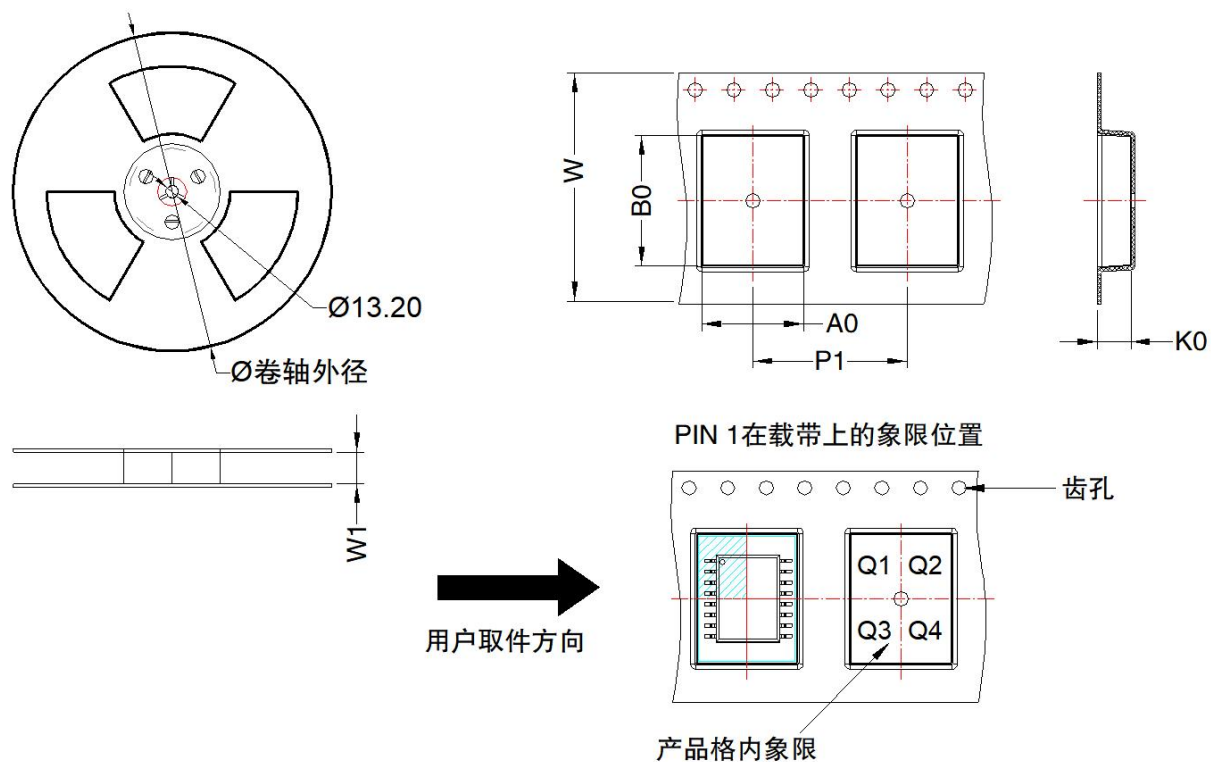


标识	尺寸(mm)	
	Min	Max
A	-	2.65
A1	0.10	0.30
A2	2.25	2.35
b	0.35	0.43
c	0.24	0.29
D	10.20	10.40
e	1.27 BSC	
E	10.10	10.50
E1	7.40	7.60
L	0.55	0.85
L1	1.40 BSC	
θ	0°	8°

R485H05S-T16

SOIC16 封装 RS485 半双工隔离收发器

包装包信息



封装类型	Pin	MPQ	卷轴外径 (mm)	卷轴宽度 $W1$ (mm)	$A0$ (mm)	$B0$ (mm)	$K0$ (mm)	$P1$ (mm)	W (mm)	Pin1 象限
SOIC16	16	340	180	16.4	10.74	10.65	3.5	16.0	16.0	Q1